

QSC-SFP+0.3G10E-850-MM-ON

Модуль оптический SFP+ CPRI/OBSAI, 850 nm, 300 м, 11,1 Gbps, MM, разъем DLC, для оборудования Nokia

Максимальная дальность связи – до 300 м

Поддержка скоростей до 11,1 Гбит/с

Поддержка интерфейса CPRI/OBSAI

Поддержка «горячей» замены модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap)

Тип оптического волокна: Multi Mode (MM)

Тип разъема: двойной LC

Физическое исполнение: SFP+

Поддержка цифрового мониторинга диагностики (DDM)

Наличие детальной информации о модуле в EEPROM

Наличие лазера, не требующего дополнительного охлаждения

Поддержка EMI и ESD защиты

Рабочая температура для модулей: -40° C до +85° C

Работа в условиях влажности 85%

Габариты – 14,6 x 56,6 x 13,35 мм.